2026/10/28

封測

力成(6239 TT)　　法說/座談摘要

前日收盤價	254.50 元

洪士勛
chris.hong@ctbcsis.com

3Q26 營運表現亮眼，營收與毛利率均創下歷史新高

- **AI 基礎建設投資強勁，持續支撐半導體及記憶體產業需求**
- **力成與 Broadcom 於新加坡成立合資公司共同開發 CPO**
- **處分毛利較低事業，改善成本結構**

結論：3Q26 營運表現亮眼，單季合併營收達 253.34 億元，毛利率 24.0%，營收與毛利率均創下歷史新高，封裝與測試產能利用率均超過 90%，4Q26 將隨營收增加續揚。展望 4Q26 營運，預期 DRAM 與 NAND/eSSD 需求持續維持高檔，高階 FCBGA 與邏輯封裝業務延續成長動能，獲利可望進一步攀升；消費性電子因記憶體漲價拉貨持續保守。公司積極佈局 FOPLP、CPO、3DIC 及高階 FCBGA，先進封裝業務已佔集團營收 30%以上，故我們持續看好公司在先進封裝業務之成長表現。

一、3Q26 財報概況：

1. 合併營收:253.34 億元(QoQ+9.6%，YoY+26.9%)，毛利率 24.0%(QoQ+2.2ppts，YoY+7.9ppts)。
2. 營業利益:44.72 億元(QoQ+26.7%，YoY+117.9%)；營業利益率 17.7%(QoQ+2.4ppts，YoY+7.4ppts)。
3. 稅後淨利:35.65 億元(QoQ+25.1%，YoY+75.2%)，營業淨利率 14.1%。
4. 每股盈餘:3.55 元；每股淨值 75.04 元。

二、3Q26 營運概況：

1. 營收比重(依服務類別): 封裝占 67%(QoQ+1ppts)、測試占 24%(QoQ+1ppts)、SiP/Module 占 9% (QoQ-2ppts)。

2. 營收比重(依產品類別): Logic IC 占 43%(QoQ+2ppts)，出貨量續增，子公司超豐簽訂 LTA 帶動營收 QoQ、YoY 續增雙位數；NAND 占 28%(QoQ-1ppts)，AI 伺服器帶旺 eSSD 需求，帶動營收持續成長；DRAM 占 20%(QoQ+1ppts)，訂單能見度高，推升營收表現穩定增長；SiP/Module 占 9%(QoQ-2ppts)。

3. CPO:與 Broadcom 於新加坡成立合資公司共同開發 CPO 與 Optical Engine，目前所有驗證均順利進行中，量產計劃維持不變。

4. 先進封裝:積極投入 FOPLP、3DIC、TSV DRAM 及高階 FCBGA 等技術開發，目前先進封裝已佔集團營收 30%以上。

5. 資本支出:前三季累計的資本支出規模約 251 億元，主要用於建置先進封裝高階設備與基礎設施。此外針對 4Q26 的資金需求（含 Broadcom 投資專案），公司於 3Q26 季末已完成後續資金準備。

三、營運展望：

1.記憶體:AI 及雲端基礎建設投資維持強勁，持續支撐半導體及記憶體產業需求。DRAM 及 NAND Flash 需求仍大於供給，產品價格趨勢有利於記憶體產業營收成長。

2.邏輯 IC:隨著 AI 市場需求持續增溫，公司在高階 FCBGA 同步受惠，既有高階產品需求亦持續擴大。預期 4Q26 高階封裝業務將延續成長動能，維持穩健向上的發展趨勢。受惠於市場供需持續緊俏，多數客戶已接受價格調整。隨著原物料價格上升所帶動的價格反映，預期 4Q26 將進一步挹注營收及獲利成長，並對整體獲利表現帶來正面貢獻。

3.先進封測:FOPLP 部分，客戶端的產品驗證正持續推進，並朝 2027 年量產目標穩定發展。此外，隨著市場需求及量產信心度提升，客戶在新產品導入的需求亦顯著增加，對未來業務注入新的成長動能。

4.預估 4Q26 營收與毛利率將在 3Q26 基礎上持續增長。目前封裝與測試產能利用率均超過 90%，4Q26 稼動率將維持高檔，公司將透過廠房重新佈局及汰舊換新提升生產效率。

四、公司/產業看法：

1.矽光子與 CPO 前景:AI 浪潮推動資料傳輸與高效能運算需求，CPO 與 Optical Engine 成為未來關鍵技術。公司從傳統記憶體封裝廠轉型為 AI 時代的異質整合與光學封裝合作夥伴，以高毛利、高技術門檻解決方案提升附加價值。

2.產能佈局與資本支出規劃:封裝與測試產能利用率均已超過 90%。2025~2026 年持續投入先進封裝高階設備，精簡中國大陸傳統封裝廠等低毛利海外資產，資金與研發能量聚焦於台灣高階先進製程據點。

3.價格調漲與成本結構改善:受原物料與封裝材料成本上升影響，公司適度將成本反映給客戶，客戶接受度高，並依市場行情進行個位數至雙位數百分比不等的價格調整。4Q26 在產能稼動率維持高檔及價格效益的雙重帶動下，預期獲利將進一步攀升。

4.業務獲利結構與轉型時程:營收結構將從過去高度依賴標準型 DRAM 與 NAND 封裝，轉變為由記憶體封測、傳統封測與先進封測共同驅動。先進封裝(包含 FCBGA、FOPLP、Bumping、3D IC 等)目前已佔集團營收 30%以上，預期 2027 年起 FOPLP 與 CPO 等新產品商業化量產，帶動營收規模與獲利占比持續顯著提升。

五、Q&A：

Q:公司如何看待未來幾年 FOPLP 與 CoPoS 在高階封裝市場的競合關係？與台積電合作之可能性及同業競爭實力？

A:台積電採用的 CoPoS 與力成的 FOPLP 為相同製程，差別在於面板尺寸。力成採用 510mm x515mm 面板，大於台積電的 310mmx310mm，因此成本具優勢，但技術門檻更高。公司不對同業競爭實力做評論，經營理念是直接服務半導體產品或系統模組公司並參與設計開發，提升附加價值，但也期待有機會與晶圓廠建立供應鏈後段策略聯盟。

Q:目前先進封裝業務占集團營收比重及未來成長動能？

A:若將 FCBGA、FOPLP、Bumping、3D 等先進封裝相關業務納入計算，目前已占集團營收 30%以上。隨著 FOPLP 等新產品逐漸明確並進入量產，2027 年起公司成長將不再依賴傳統記憶體景氣循環，而是由記憶體封測、傳統封測與先進封測共同驅動，先進封裝營收規模及佔比將持續提升。

Q:力成目前的技術是否能夠做到 EMIB / bridge 的封裝方式？目前是否已經有客戶採用此封裝技術？

A:公司目前已具備 EMIB-like 的技術能力，Intel 是將 Bridge Die 嵌入在 ABF 載板內，而公司是將 Bridge Die 嵌入 polymer。EMIB 需要 Mix Bridge Bump，做不同 Bump-pitch 在上面會影響產能，惟公司目前仍以內部產能為主，暫未打算向外提供服務。

Q:公司設備交期是否會影響 FOPLP 的量產時程？

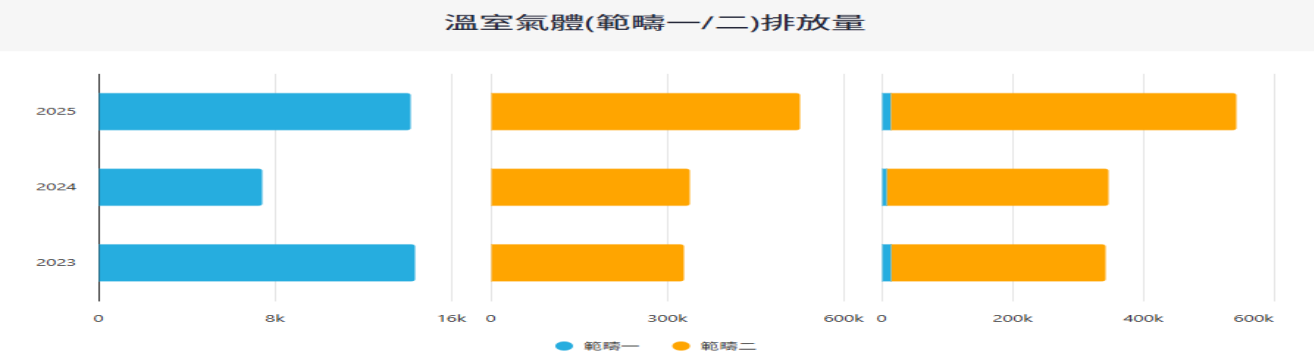
A:半導體設備市場需求雖仍吃緊，但在採購、工程人員與策略供應商全力配合協助下，缺機台情況已明顯改善。力成 2027 年至 2028 年的產能擴充均按計劃進行，不會因機器設備影響未來的 FOPLP 量產時程。

Q:當初選擇 510mm x 515mm 面板尺寸的主要考量？

A:公司在 2014~2015 年即針對各種 IC 尺寸進行數據化模擬計算，結果顯示 510mmx515mm 的面板面積利用率優於 310mmx310mm 或 600mmx600mm；且在製程化學與品質控制上，從中心點到邊緣的品質均一性技術瓶頸較為可控，因此採用 510mmx515mm 尺寸。

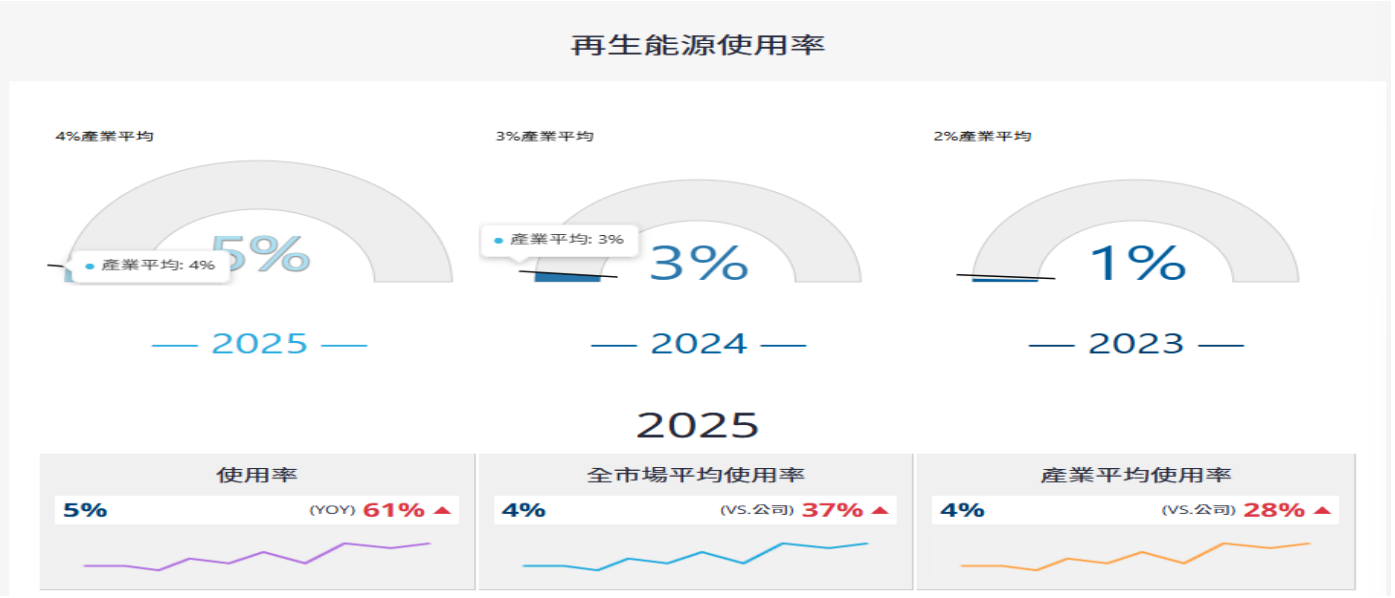
2026/10/28

ESG 資訊 -環境保護 (Environmental)



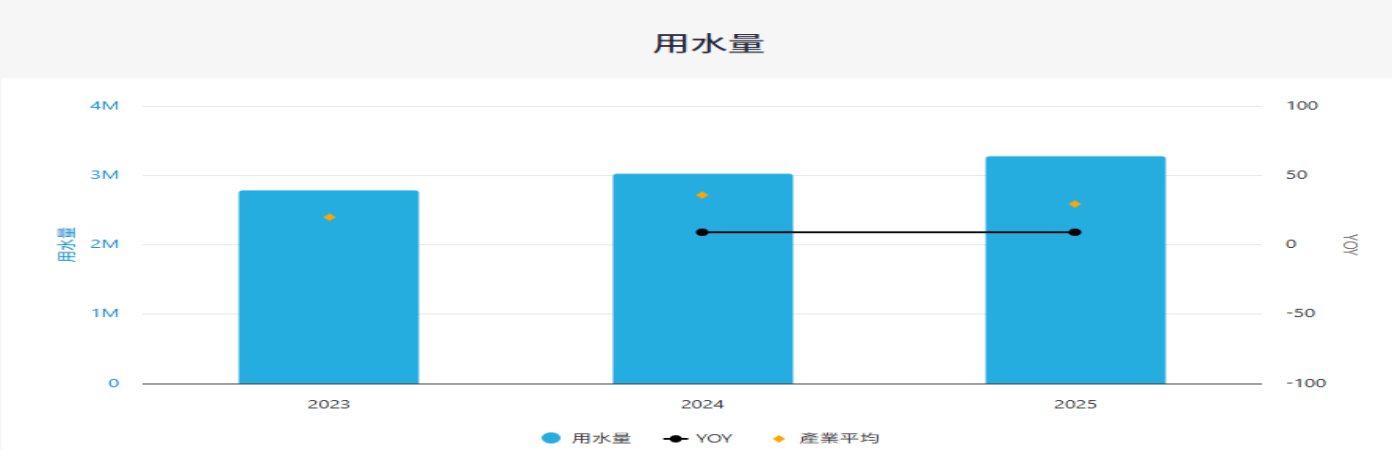
2025

總排放量	範疇一	範疇二
541.61K (YOY) 56% ▲	14.17K (YOY) 90% ▲	527.44K (YOY) 55% ▲



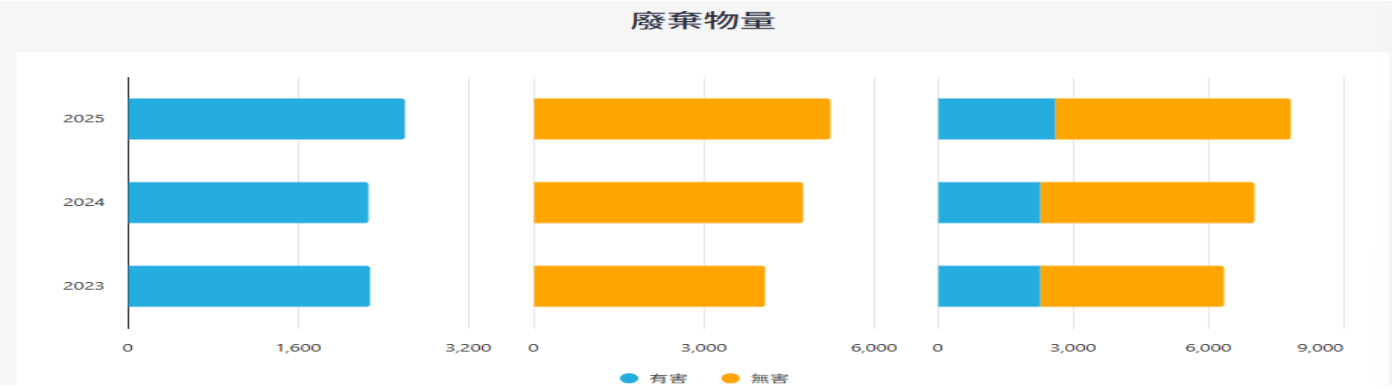
2025

使用率	全市場平均使用率	產業平均使用率
5% (YOY) 61% ▲	4% (VS.公司) 37% ▲	4% (VS.公司) 28% ▲



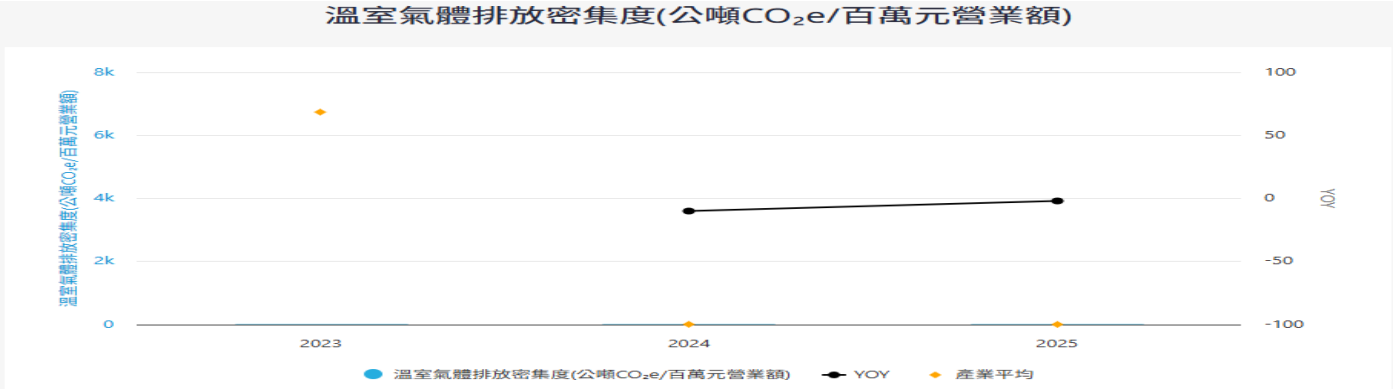
2026/10/28









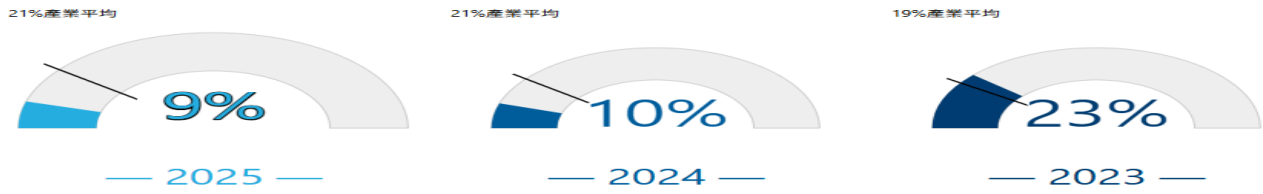




ESG 資訊 -社會責任 (Social)

2026/10/28

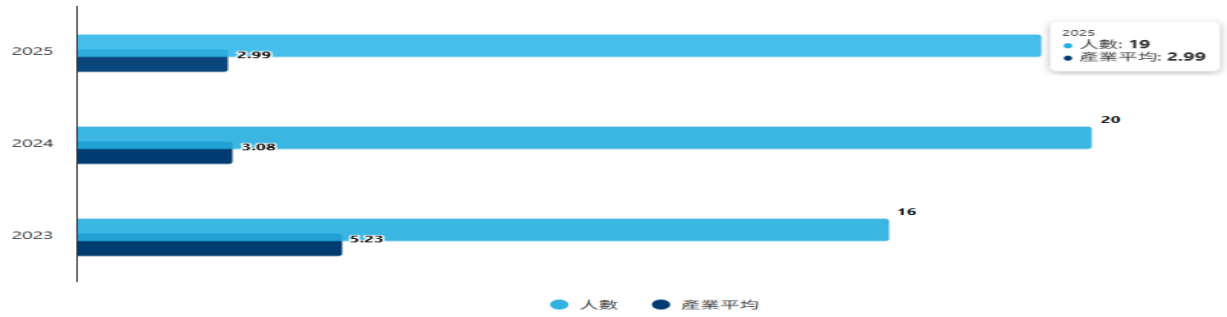
管理職女性主管占比



2025

占比	全市場平均占比	產業平均占比
9% (YOY) -3% ▼	28% (YOY) 2% ▲	21% (YOY) 4% ▲

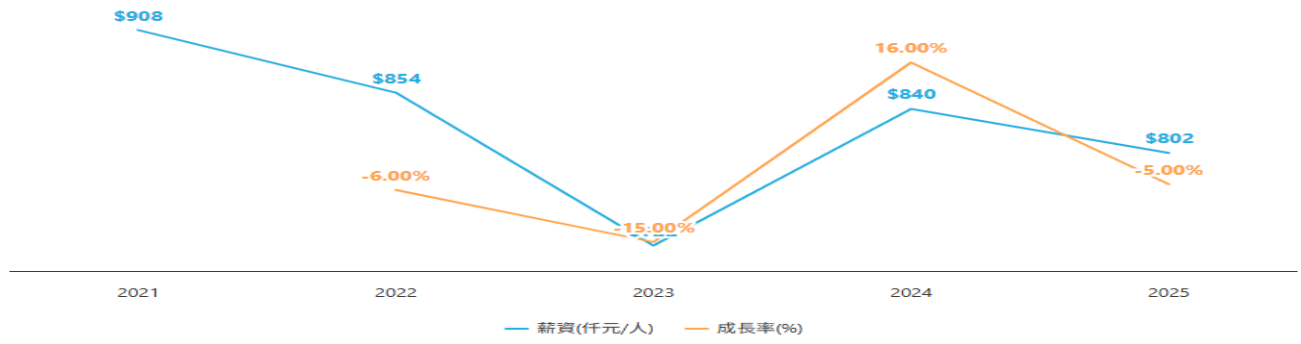
職業災害人數



2025

人數	全市場平均人數	產業平均人數
19 (YOY) -5% ▼	5 (VS.公司) 1% ▲	3 (VS.公司) -3% ▼

員工薪資年度趨勢

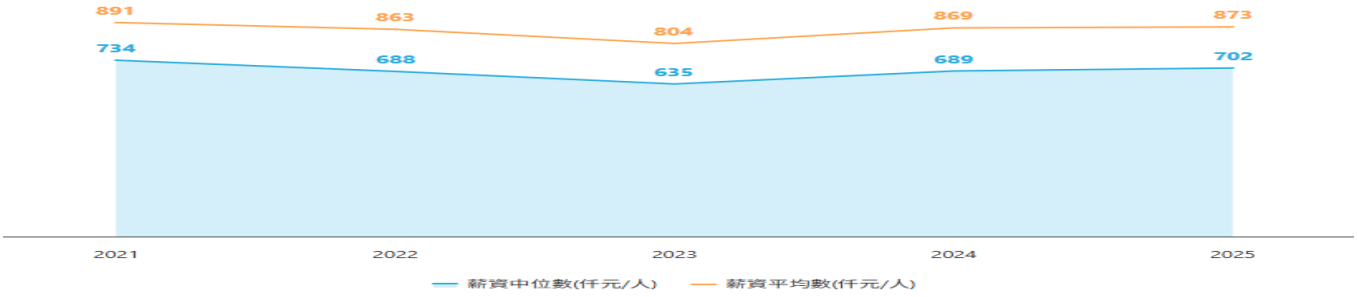


2025

員工薪資平均數	與去年同期比	與同產業薪資比
802	-5% ▼	-68.92%

2026/10/28

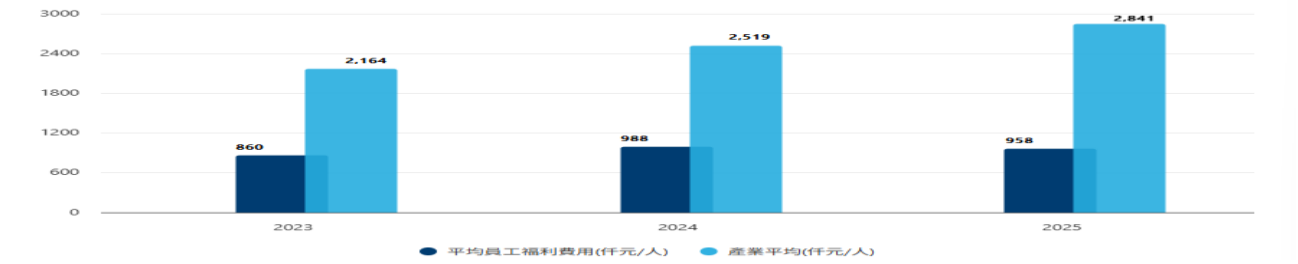
非擔任主管職務之全時員工薪資



2025

平均數	中位數	差異%
873 (YOY) 0% —	702 (YOY) 2% ▲	0% (YOY) -8% ▼

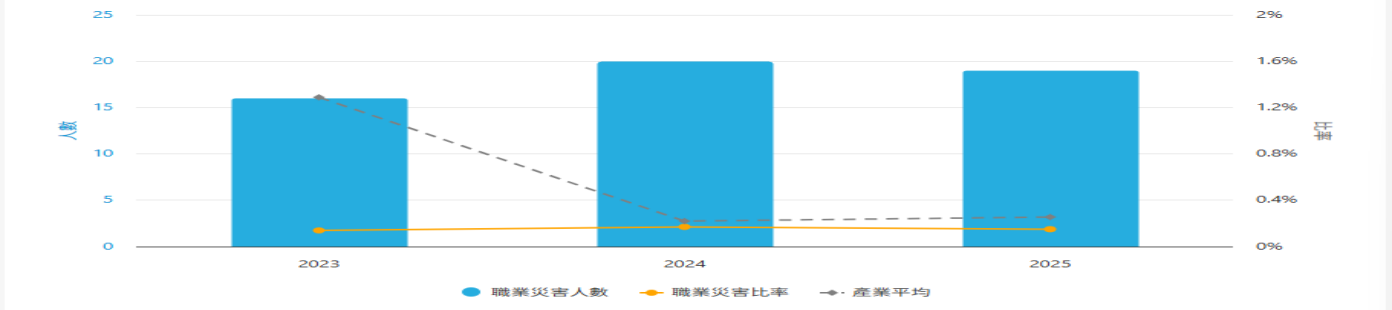
平均員工福利費用



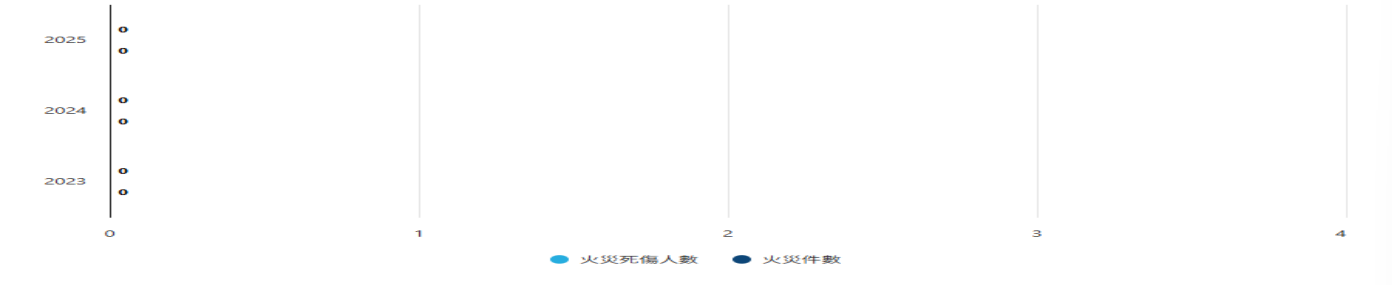
2025

平均福利	全市場平均福利	產業平均福利
958 (YOY) -3% ▼	1,350 (YOY) 3% ▲	2,841 (YOY) 13% ▲

職業災害人數與比率

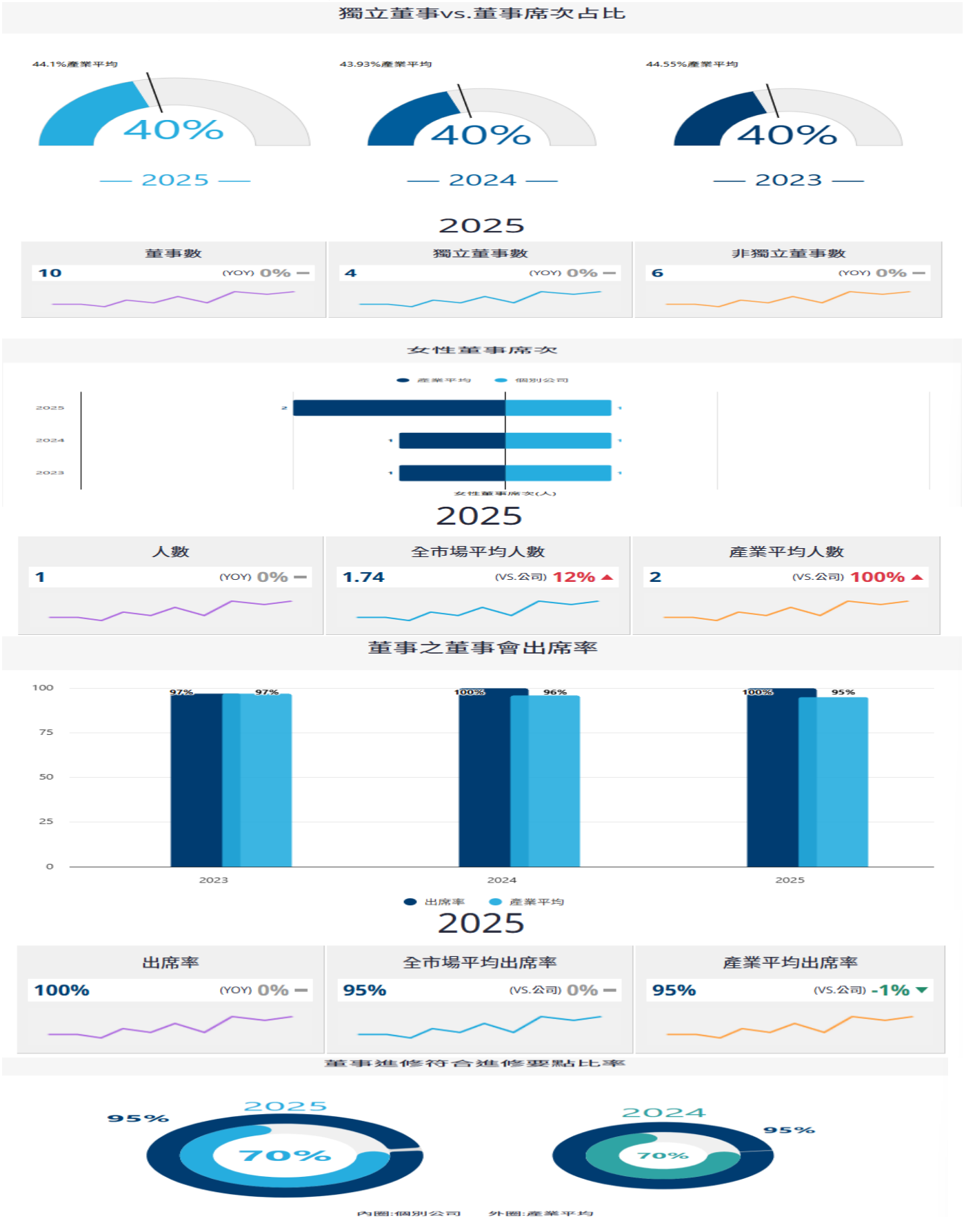


火災件數與死傷人數



2026/10/28

ESG 資訊 -公司治理 (Governance)



2026/10/28



資料來源：證交所

2026/10/28

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱"中信金集團"）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司
台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988
營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號